

ATM-8200A

全自動ウェーハマウンター Full-Automatic Wafer Mounter

【概要 - Outline -】

◆ダイシング前工程として、専用フレームへのウェーハマウントを全自動で行う装置です。

The machine automatically mounts a wafer on a film frame as preliminary process for dicing.

装置サイズは世界最小で真空チャンバーの採用により、極薄ウェーハ（厚み：175 μ m / ϕ 8 インチ）にも対応できます。

Foot print of this machine is the smallest in the world, and it's also available with thinner wafer (thickness:200 μ m/8 inches) by the use of chamber.

【特長 - Features -】

◆世界最小サイズの ϕ 4・5・6・8 インチ対応の全自動ウェーハマウンターです。

Full automatic wafer mounter available with 4・5・6・8 inches (the smallest foot print in the world) .

◆テープにウェーハを真空中で貼付けますので、気泡の発生が無く、貼付けローラーの荷重も少なく済み、

Mount the wafer onto the tape in vacuum chamber will prevent from air bubbles, minimize the load of the pressing roller,

ウェーハダメージを与えません。

and provide no damage to the wafer.

◆特殊テーブルの使用により、外周 3mm を除くウェーハ表面は完全にノーコンタクトで、且つ、吸着による

The mounting table is non contact with wafer surface at all except around 3mm in its circumference,

ウェーハ固定を行いませんので、ウェーハへダメージを与えません。

and wafer position fixing with no vacuum hole will provide no damage to the wafer.

◆専用フレームにテープを貼付けるステージとテープにウェーハを貼付けるステージを別に設けていますので、

Tape lamination stage and wafer mounting stage is separated.

テープの使用量が低減され、且つ、どのようなテープにも対応が出来ます。

It saves tape consumption and it's applicable to any dicing tape.

◆操作は見やすいタッチパネル式で、トラブル時の状況も表示します。

Touch pane (1 flat operation panel) is easy to operated, and able to indicate troubled point.

◆非接触オリフラ合わせを標準装備しています。

Non contact flat alignment (standard spec) .



仕様 Specification		ATM-8200A
スループット Throughput		95 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェーハサイズ Wafer Size		4・5・6・8 inch
フレームサイズ Frame Size		2-6-1 / 2-8-1
使用テープ幅 Tape Width		6 inch : W 230 mm / 8 inch : W 300 mm
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 50/60Hz 2.0KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5Mpa 300NI/min
装置寸法 Demension		W 1,326 × D 1,150 × H 1,800 mm
重量 Weight		700 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.